

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2026 年 3 月 5 日 (05.03.2026)



(10) 国际公布号
WO 2026/045203 A1

(51) 国际专利分类号:
H01L 23/538 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2025/080724

(22) 国际申请日: 2025 年 3 月 5 日 (05.03.2025)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202411183523.4 2024年8月26日 (26.08.2024) CN

(71) 申请人: 长鑫科技集团股份有限公司 (**CXMT CORPORATION**) [CN/CN]; 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号 230601 (CN)。

(72) 发明人: 王海林 (**WANG, Hailin**); 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号 230601 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,

GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(54) **Title:** PACKAGING STRUCTURE AND PACKAGED DEVICE

(54) 发明名称: 封装结构、封装器件

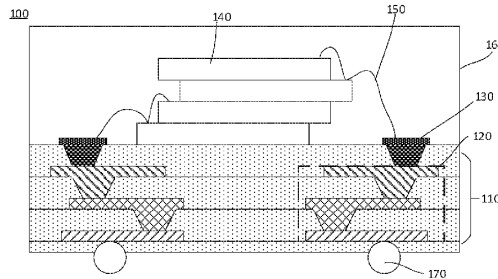


图 1

(57) **Abstract:** A packaging structure and a packaged device. The packaging structure comprises: a dielectric layer; a first redistribution layer located in the dielectric layer; a second redistribution layer located on the first redistribution layer, the first redistribution layer being electrically connected to the second redistribution layer, and the top of the second redistribution layer protruding beyond the dielectric layer; a chip located on the dielectric layer; and a bond wire connecting the chip and the second redistribution layer. The thickness of the packaging structure is small.

(57) 摘要: 一种封装结构和封装器件。封装结构包括: 介质层; 第一重布线层, 位于所述介质层中; 第二重布线层, 位于所述第一重布线层上, 所述第一重布线层与所述第二重布线层电连接, 所述第二重布线层的顶部突出于所述介质层; 芯片, 位于所述介质层上; 引线, 连接所述芯片和所述第二重布线层。该封装结构的厚度小。



WO 2026/045203 A1